

# 美出口限制奏效 中國華為最新筆電使用舊晶片技術

資料蒐集: 中央社

加拿大研究機構 **TechInsights** 報告指出，中國華為公司最新推出的筆記型電腦 **MateBook Fold** 所搭載晶片是中芯國際多年前舊的晶片技術，顯示美國的出口管制已對中國半導體技術研發構成阻礙。

路透社 23 日引述 **TechInsights** 的報告做了上述報導。據表示，業界原本普遍預期華為將在 **MateBook Fold** 採用中芯國際的最新製程，也就是等同於 5 奈米的 N+3 製程節點晶片，但實際上這款筆電搭載的麒麟 X90 晶片仍採用中芯國際 2023 年 8 月首次推出的 7 奈米 N+2 製程節點。

華為智慧手機 **Mate 60 Pro** 當年採用這項晶片技術時曾震驚美國負責出口管制的官員。如今先進晶片製造領導廠商台積電已預定於今年稍晚時開始量產 2 奈米晶片，比 7 奈米技術超前三代。

**TechInsights** 的報告表示，華為最新電腦產品採用舊晶片技術「很可能意味著中芯國際尚未實現可量產的等同 5 奈米製程節點」「美國實施的技術管制措施，很可能持續影響中芯國際在行動裝置、個人電腦以及雲端／人工智慧（AI）應用等先進晶片製程節點上的追趕能力。」

華為上個月發表的新款電腦結合了折疊式筆記型電腦和平板電腦特點，搭載自主研發的鴻蒙作業系統。配合中國當局減輕依賴西方科技的政策，華為的產品已逐步使用更多的國產技術和零組件，同時也試圖挑戰蘋果（**Apple**）和微軟（**Microsoft**）。

不過，中國在獲得下一代晶片製造技術方面遭遇重大挑戰。美國禁止荷蘭晶片製造設備生產商艾司摩爾（**ASML**）對中企出口極紫外光（**EUV**）微影設備，而 **EUV** 又是製造先進 AI 晶片所必需。**TechInsights** 的報告提到，中國本土晶圓廠如今只能依賴效率較低的多重曝光技術，導致良率下降。

美國商務部次長凱斯勒（**Jeffrey Kessler**）本月稍早在美國國會聽證會上表示，受到美國出口管制的影響，華為今年預計只能生產約 20 萬顆昇騰 AI 晶片。